정보관리기술사 데일리 다이제스트

2026-10-06 · 국내/국제/공공 12대 도메인 매핑

1. 오늘의 브리핑

축	도메인	헤드라인	키워드
국내	SE LAW 정보보안	**금융권 침해사고 잇따라, 당국 보안체계 긴급 재점검** 금융보안 거버넌스 책임 강화 사례 · dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=208726	금융보안 · 침해사고 · 재발방지 · 보안거버넌스
국제	CA AI 컴퓨터구조	**올트먼 투자 볼란티스, 광학 인터커넥트로 메모리월 돌파** 차세대 AI 가속기 인터커넥트 기술 전환 · theregister.com/systems/2026/10/05/altman-backed-volantis-reveals-plan-to-vault-the-memory-wall-by-baking-photonics-into-ai-accelerators/5300959	메모리월 · 포토닉스 · AI가속기 · CXL
공공·정책	LAW IM 법·규제	**개인정보위, 유출사고 조사체계 신속·공정성 강화** **근거** 「개인정보 보호법」 · 침해사고 조사 신뢰성·투명성 제고 · pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=D010030000&nttId=12555	개인정보보호법 · 조사체계 · 침해사고대응

2. 오늘의 토픽 — 광학 인터커넥트 기반 메모리월 극복(Photonic Interconnect for Memory Wall)

CA AI NW | 출제 예상: **1교시** | 근거: **UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express), CXL(Compute Express Link)**

2-1. 개념 및 정의

메모리-연산 유닛 간 대역폭·지연 한계를 광신호 배선으로 극복하는 상호연결 기술. 전기 배선의 대역폭·전력 한계를 넘는 대규모 AI 가속기 설계 수단.

2-2. 등장 배경

HBM 용량·전력 한계가 AI 가속기 성능 확장의 최대 제약으로 부상. 빅테크·스타트업이 광학 인터커넥트로 차세대 AI 인프라 경쟁력 확보 시도.

2-3. 핵심 기술요소

분류	주요 기술요소	역할 및 메커니즘
메모리 인터커넥트	CXL, UCIe, HBM4	칩 간 고속 저지연 연결 표준
광학 기술	CPO, 실리콘 포토닉스, 광트랜시버	전기신호를 광신호로 변환해 전송
AI 가속기 아키텍처	NPU, 칩렛(Chiplet), 근메모리 연산(PIM)	연산-메모리 거리 단축으로 대역폭 확보

2-4. 시험·실무 관점

- [CA 연계] 메모리월·대역폭 한계와 칩렛 아키텍처 비교 논제
- [AI 연계] 거대 모델 학습·추론의 인프라 제약과 해법

답안 필수 키워드 — 메모리월 / 포토닉스 / CXL / HBM4 / 칩렛